

上海费尔德新材料有限公司

Shanghai Fairfield New Materials Co.,Ltd.

电话: +86-21-54480018 传真: +86-21-54480017

销售热线: 4001002590



EG-4900GBF 导电环氧粘接胶

产品介绍

EG-4900GBF 导电环氧粘接胶是一种专为微电子和光电子应用中芯片接合而设计的双组分、银填充的环氧树脂系统。EG-4900GBF 具有高导热性，可用于热管理应用。EG-4900GBF 导电环氧粘接胶可应用于光电封装材料-LED、LCD 和光纤组件，塑料 IC 封装、大功率器件和大电流、大功率 LED，还可以用于高速环氧树脂芯片接合。

典型属性

混合粘度, cp (50rpm, 25℃)	4000-6000
工作寿命 (25g), 小时	>48

典型固化特性

颜色	银色
比重	2.6-2.7
硬度, shore D	75
对铝搭接剪切强度, psi	1600
体积电阻率, ohm-cm	<0.0004
玻璃化温度 (Tg), °C	100
导热系数, W/m.K	2.5
工作温度 (Tg), °C	
连续工作	-55 至 200
间断工作	-55 至 300
热膨胀系数, 10 ⁻⁶ /°C	
α1	30
α2	150
粒度, 微米	<45
离子杂质, ppm	
氯离子	<100
钠离子	<20
钾离子	<20

上述为产品在 150℃下固化 1 小时的数据

工厂地址: 上海市松江区文松路 333 弄中电信息港 1 幢 102 室

上海费尔德新材料有限公司

Shanghai Fairfield New Materials Co.,Ltd.

电话: +86-21-54480018 传真: +86-21-54480017

销售热线: 4001002590



使用方法

该产品具有装在 4 盎司、8 盎司和 1 磅的容器中的双组份套件；也具有装在 3cc、5cc 和 10cc 的一次性注射器中的预混合和冷冻粘合剂。

应用-该产品需要在室温下解冻 5 至 10 分钟。在进行使用前将每种组分彻底混合；使用时将粘合剂（组分 A）加入到硬化剂（组分 B）中以重量比为 1:1 比例混合，再混合搅拌过程中建议反复刮容器的侧面和底部以保证混合均匀；将产品涂敷于清洁的粘合表面，可通过点胶、丝网印刷、模压或手工等方式涂敷；并按照建议进行固化以取得所需性能。

固化-该产品在 80℃ 下需要固化 180 至 200 分钟。在 100℃ 下需要固化 120 至 150 分钟。在 120℃ 下需要固化 15 至 20 分钟。在 150℃ 下需要固化 5 至 6 分钟。在 175℃ 下固化时间应小于 1 分钟。最佳的固化条件将因应用情况而异，建议使用推荐的固化方案以确定典型的固化性能，使用其他的固化方案可能会导致某些性能出现差异。

保质期/储藏要求

预混合套装在 -40℃ 时，保质期自制造之日起一年。双组分套装在 25℃ 下，保质期自制造之日起一年。此材料已被冷冻运输。材料应冷冻保存，直到准备使用。请参考解冻时的处理说明。

警示信息

使用本品或公司任何产品之前，请参阅材料安全数据表和产品标签上关于安全使用和储运的说明。该产品仅可用于工业/商业用途。使用本品者事先必须接受相关培训。不得用于家庭用途。不得用于消费品。